

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局(43) 国際公開日  
2004 年 11 月 4 日 (04.11.2004)

PCT

(10) 国際公開番号  
WO 2004/095363 A1

- (51) 国際特許分類<sup>7</sup>: G06K 17/00, G06F 12/06, 3/06, 3/08  
 (21) 国際出願番号: PCT/JP2003/015833  
 (22) 国際出願日: 2003 年 12 月 11 日 (11.12.2003)  
 (25) 国際出願の言語: 日本語  
 (26) 国際公開の言語: 日本語  
 (30) 優先権データ:  
 特願2003-118242 2003 年 4 月 23 日 (23.04.2003) JP  
 (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 松下電  
 器産業株式会社 (MATSUSHITA ELECTRIC INDUS-  
 TRIAL CO., LTD.) [JP/JP]; 〒571-8501 大阪府 門真市  
 大字門真 1 0 0 6 番地 Osaka (JP).  
 (72) 発明者; および  
 (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 太田 晴夫

(OHTA, Haruo) [JP/JP]; 〒610-0352 京都府 京田辺  
 市 花住坂 1-2 2-1 8 Kyoto (JP). 大塚 健 (OHT-  
 SUKA, Takeshi) [JP/JP]; 〒662-0018 兵庫県 西宮市 甲  
 陽園山王町 1-3 3 Hyogo (JP).

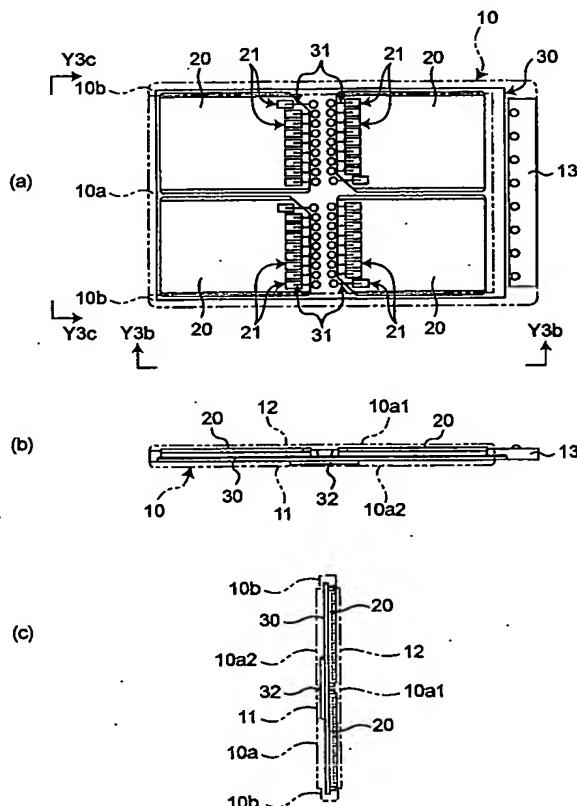
(74) 代理人: 河宮 治, 外 (KAWAMIYA, Osamu et al.); 〒  
 540-0001 大阪府 大阪市中央区 城見 1 丁目 3 番 7 号  
 IMPビル 青山特許事務所 Osaka (JP).

(81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB,  
 BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE,  
 DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM,  
 HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KR, KZ, LC, LK, LR, LS,  
 LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI,  
 NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG,  
 SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ,  
 VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

[続葉有]

(54) Title: SEMICONDUCTOR RECORDING DEVICE

(54) 発明の名称: 半導体記憶装置



(57) Abstract: A semiconductor recording device is characterized in that it comprises a PC card type housing that is 5.0 mm thick and that has a card bus connector for connection to a host device; four SD memory cards (R) contained in the housing; and a control circuit for controlling signal transmission and reception between the card bus connector and the SD memory cards (R). The semiconductor recording device is suitably used as a recording medium of the host device that desirably has a higher data transfer rate and a larger storage capacity. Additionally, the semiconductor recording device is attachable to and removable from the host device and portable, and can be made at a relatively low cost. The semiconductor recording device also can be used while having been directly inserted in a notebook personal computer.

(57) 要約: 本発明の半導体記憶装置は、ホスト装置と接続するためのカードバスコネクタを有するPCカード型の厚さ5.0mmの筐体と、該筐体内に収納された4枚のSDメモリカード(R)と、カードバスコネクタと各SDメモリカード(R)との間の信号の送受信を制御する制御回路とを備えたことを特徴とし、より高いデータ転送レートとより大きな記憶容量が求められるホスト装置の記録媒体として用いるのに適し、しかも、ホスト装置との着脱が可能で持ち運びができる比較的低価格の半導体記憶装置を提供でき、また、ノート型パーソナルコンピュータにおいても、直接に挿入して使用できる。



(84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告書

2 文字コード及び他の略語については、定期発行される各 *PCT* ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

## 明 細 書

## 半導体記憶装置

## 5 技術分野

この発明は、例えばビデオカメラレコーダやノート型パーソナルコンピュータ等のホスト装置に対し着脱が可能な半導体記憶装置に関する。

## 背景技術

10 近年、フラッシュメモリなどの不揮発性半導体メモリの大容量化の進展に伴い、ホスト装置に対し着脱が可能で持ち運びが容易な各種のメモリカードが普及している。

このようなメモリカードの1種に、PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association) がPCカード規格 (PC Card Standard) として規格化している、PCカードサイズのものがある。

このPCカード規格では、カード形状、並びにカードの幅、長さ、最大厚さなどの基本諸元についての呼び寸法及びその公差など、カードの物理的な形状及びサイズが規定される他、ホスト装置との信号インタフェースも規定されている。

20 例えば、カードの物理的サイズとしては、幅の呼び寸法が54.0mm、長さの呼び寸法が85.6mmで、最大厚さ部分の厚さの呼び寸法が5.0mmのもの (タイプ2: Type II) や、幅と長さがタイプ2と同じで、最大厚さ部分の厚さの呼び寸法が10.5mmのもの (タイプ3: Type III) などが規定されている。

25 また、最近、特に民生分野で普及が進んでいるメモリカードとして、前記PCカードよりも小型で、例えばデジタルカメラや携帯型オーディオプレーヤなどの民生機器の記録媒体として用いられる、いわゆる小型メモリカードがある。

このような小型メモリカードとしては、所謂、コンパクトフラッシュ (R) カード、スマートメディア (R)、メモリースティック (R)、SDメモリカード

(R) などが知られている。「インターフェース、1999年12月号、p. 52～p. 55、(CQ出版社)」には、これらのカードの例が開示されている。尚、上記SDメモ리카ード(R)は、SDアソシエーション(SD Association)により、その形状及びサイズ等の規格が定められている。

5

#### 発明の開示

ところで、例えば、高画質な動画を長時間記録するビデオカメラレコーダなどにおいて、記録媒体としてメモ리카ードを利用する場合には、記録ないし再生に必要なデータ転送速度が非常に高くなり、また記録すべきデータ容量も膨大なものとなる。このため、上述のSDメモ리카ード(R)などの小型メモ리카ードでは、データ転送速度や記憶容量が必ずしも十分ではなく、より高速でより大容量の記憶装置が求められるようになって来ている。

10

15

また、例えば、通常のノート型パーソナルコンピュータでは、PCカード用スロットが設けられることはあっても、このような小型メモ리카ードを直接挿入できるスロットは一般に設けられていない。従って、小型メモ리카ードに記録した内容をパーソナルコンピュータで確認したり、記録したデータをパーソナルコンピュータで編集したりする場合には、PCカード用スロットに挿入可能なアダプタや、USB接続が可能なアダプタを別途に用意する必要があり、非常に不便である。

20

尚、メモ리카ードでPCカードサイズのものもあるが、かかるタイプのメモ리카ードは、近年では限定された産業用途のみが主たる市場となっており、民生用途で幅広く普及が進んでいる小型メモ리카ードに比べて、高速化や大容量化の進展が比較的遅く、また価格も高くなっているのが現状である。

25

本発明は、以上の状況に鑑みてなされたもので、その目的は、例えば高画質な動画を長時間記録するビデオカメラレコーダなど、より高いデータ転送レートとより大きな記憶容量が求められるホスト装置に対して、その記録媒体として用いるのに適し、しかも、ホスト装置との着脱が可能で持ち運びができ、かつ比較的低価格の半導体記憶装置を提供することである。

また、本発明の他の目的は、データ転送レートが高速で、記憶容量が大きく、

比較的低価格で実現でき、しかも、例えば、一般的なノート型パーソナルコンピュータなど、小型半導体メモリカード用の挿入スロットを備えていないホスト装置に対しても、直接に挿入して使用できる半導体記憶装置を提供することである。

このため、本発明の半導体記憶装置は、ホスト装置と接続するための接続部を有する筐体と、該筐体内に収納された複数の小型半導体メモリカードと、前記接続部と前記複数の小型半導体メモリカードとの間の信号の送受信を制御する制御手段と、を備えたものである。

この構成によれば、比較的廉価な小型半導体メモリカードを複数用いることで、高いデータ転送レートと大きな記憶容量を低価格で実現し、かつホスト装置と接続するための接続部を有する筐体に制御手段とともに収めることで装置との着脱が可能で持ち運びが可能となる。

また、本発明の半導体記憶装置は、筐体がPCカード規格タイプ2に準拠した大きさであり、SDメモリカード(R)規格に準拠した小型半導体メモリカードを4枚備えた構成にすることもできる。

この場合、データ転送レートが高速で、記憶容量が大きく、比較的低価格で実現できるとともに、例えば一般的なノート型パーソナルコンピュータなど、小型半導体メモリカード用のスロットを備えていないホスト装置についても、直接に挿入して使用することが可能となる。

本発明によれば、例えば高画質な動画を長時間記録するビデオカメラレコーダなど、より高いデータ転送レートとより大きな記憶容量が求められるホスト装置に対して、その記録媒体として用いるのに適し、ホスト装置との着脱が可能で持ち運びができ、かつ比較的低価格で得られる薄型でカード状の半導体記憶装置が得られる。

また、例えば、一般的なノート型パーソナルコンピュータなど、SDメモリカード(R)等の小型半導体メモリカード用の挿入スロットを備えていないホスト装置にも、専用のアダプタ等を用いることなく、直接に挿入して使用することができ、小型半導体メモリカードに記録した内容をパーソナルコンピュータ等のホスト装置で確認したり、記録したデータを編集したりするなどのデータの取り扱いが容易に行えるようになるという、効果も得られる。

## 図面の簡単な説明

図 1 は、本発明の実施形態に係る半導体記憶装置の外形形状及びサイズを示す説明図で、図 1 (a) は平面図、図 1 (b) は図 1 (a) の Y 1 b - Y 1 b 矢印方向からの側面図、図 1 (c) は図 1 (a) の Y 1 c - Y 1 c 矢印方向からの側面図である。

図 2 は、前記半導体記憶装置の分解斜視図である。

図 3 は、前記半導体記憶装置の内部構造を示す説明図で、図 3 (a) は平面図、図 3 (b) は図 3 (a) の Y 3 b - Y 3 b 矢印方向からの側面図、図 3 (c) は図 3 (a) の Y 3 c - Y 3 c 矢印方向からの側面図である。

図 4 は、図 3 (c) を拡大して示す説明図である。

図 5 は、前記半導体記憶装置の内部構造を示す説明図で、図 5 (a) は小型半導体メモリカード 20 の組付完了状態を示す斜視図、図 5 (b) は一部の小型半導体メモリカード 20 のスライド途中の状態を示す斜視図である。

図 6 は、前記半導体記憶装置の制御の概略を示すブロック構成図である。

図 7 は、前記半導体記憶装置の小型半導体メモリカードの外形形状及びサイズを示す説明図で、図 7 (a) は平面図、図 7 (b) は図 7 (a) の Y 7 b - Y 7 b 矢印方向からの側面図、図 7 (c) は底面図、図 7 (d) は図 7 (c) の Y 7 d - Y 7 d 矢印方向からの側面図である。

## 発明を実施するための最良の形態

以下、本発明の実施形態について、添付図面を参照しながら詳細に説明する。

図 1 は本実施形態に係る薄型でカード状の半導体記憶装置の外形形状及びサイズを示す説明図で、図 1 (a) は平面図、図 1 (b) は図 1 (a) の Y 1 b - Y 1 b 矢印方向からの側面図、図 1 (c) は図 1 (a) の Y 1 c - Y 1 c 矢印方向からの側面図である。また、図 2 は、前記半導体記憶装置の構造の概略を示す分解斜視図である。

これらの図に示すように、本実施形態に係る半導体記憶装置 1 は、基本的な構成要素として、下側部材 11 と上側部材 12 とを組み合わせ形成される筐体 1

0（ケース）と、この筐体10内に収納される複数の小型半導体メモリカード20とを備えている。この小型半導体メモリカード20は、樹脂パッケージされた半導体メモリ装置であり、所定形状およびサイズの平板カード状に形成されている。尚、後述するように、本実施形態では、この小型半導体メモリカード20として、SDアソシエーションのSDメモリカード（R）規格に準拠したメモリカードが用いられている。

上記下側部材11の長手方向における一端側には、ホスト装置（不図示）と接続するための接続部としてのカードバスコネクタ13が保持されている。このカードバスコネクタ13は、従来公知のものと同様のもので、この半導体記憶装置1を利用するビデオカメラレコーダやパーソナルコンピュータなどのホスト装置（図示せず）との接続に用いるコネクタである。また、筐体10の前記カードバスコネクタ13と反対側の端面には、書き込み禁止スイッチ8が設けられている。

前記筐体10は、平面視で実質的に矩形状に形成され、その短辺方向における所定幅の両端部分10bが同方向における中間部分10aよりも薄く設定されている。この筐体10内に4枚の小型半導体メモリカード20が平面状に収納される。すなわち、この筐体10の短辺方向に2枚の小型半導体メモリカード20が並べて配設され、かつ、長辺方向にも2枚の小型半導体メモリカード20が並べて配設されている。

前記中間部分10aは、両端部分10bから筐体10の厚さ方向における片方および他方（図1（b）における上方および下方）へそれぞれ張り出す第1及び第2張出部10a1及び10a2を備えており、4枚の小型半導体メモリカード20は前記第1張出部10a1側に収納されている。一方、第2張出部10a2側には、当該半導体記憶装置1の制御手段（後述する）が配設されている。

次に、前記半導体記憶装置1の内部構造について説明する。

図3は前記半導体記憶装置1の内部構造を示す説明図で、図3（a）は平面図、図3（b）は図3（a）のY3b-Y3b矢印方向からの側面図、図3（c）は図3（a）のY3c-Y3c矢印方向からの側面図である。図4は図3（c）を拡大して示す説明図である。また、図5は前記半導体記憶装置1の内部構造を示す斜視図で、図5（a）は小型半導体メモリカード20の組付完了状態を示し、

図5 (b) は一部の小型半導体メモリカード20のスライド途中の状態を示している。尚、図3 (a) , (b) 及び(c) 並びに図4においては何れも、筐体10は仮想線(2点鎖線)で示されている。

これらの図に示すように、筐体10内には、前記小型半導体メモリカード20を保持する保持板としての役割を兼ねる回路基板30が配設されている。すなわち、この回路基板30の片面(図3 (b) における上面)が前記メモリカード20の保持部を構成しており、4枚の小型半導体メモリカード20は、この回路基板30の片面に平面状に並べて保持されている。

一方、回路基板30他面(図3 (b) における下面)側には、前記カードバスコネクタ13と前記複数(4枚)の小型半導体メモリカード20との間の信号の送受信を制御する制御手段としての制御回路32が配設されている。

また、この回路基板30の短辺方向における両縁部分は、前記筐体10の短辺方向における両端部分10b内に保持されている。

次に、前記半導体記憶装置1のサイズ等について具体的に説明する。

本実施形態では、筐体10の大きさは、図1 (a) , (b) , (c) に示されるように、幅の呼び寸法が54.0mm、長さの呼び寸法が85.6mm、最大厚さ部分の呼び寸法が5.0mmに設定されている。

前述のように、筐体10は、その短辺方向における所定幅の両端部分10bが同方向における中間部分10aよりも薄く設定され、この中間部分10aは、筐体10の厚さ方向における片方および他方へそれぞれ張り出す第1及び第2張出部10a1及び10a2を備えており、この中間部分10aが最大厚さ部分を構成している。具体的には、幅方向の中央部に幅48.0mmに渡って設けられた中間部分10aの厚さの呼び寸法が5.0mmであり、幅方向の左右の両端に設けられた幅3.0mm(= (54.0 - 48.0) / 2)の両端部分10bについては、厚さの呼び寸法が3.3mmとなっている。

この図1に示した筐体10の外形形状及びサイズは、PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association) が、PCカード規格のタイプ2型 (Type II) として規格化している大きさに準拠したものである。



尚、PCMCIAの規格カードとしては、このタイプ2型以外に、全体の厚さの呼び寸法が3.3mm（一定）に規定されたPCカード規格タイプ1型（Type I）などがある。前記筐体10の幅方向の両端部分10bの厚さが中間部分10aに比べて薄く設定されているのは、両端部分10bの厚さ（呼び寸法3.3mm）を、前記PCカード規格タイプ1型（Type I）などと共通にすることで、ホスト機器側の挿入スロットのガイドレールの幅を統一し、タイプ1型やタイプ3型が同じスロットに挿入できるように考慮されたことによるものである。

このPCカード規格におけるタイプ2型の外形形状およびサイズについては、例えば、「PC Card Standard 8.0、Volume 3 Physical Specification、p. 39、2001年発行、PCMCIA」に明記されている。前記カードバスコネクタ13の外観についても、同書のp. 64に記載されている。

尚、上述の各呼び寸法の数値は、各サイズに対する標準寸法を示す数値であり、PCMCIAが定める規格に基づいて、それぞれ若干の公差が許容されている。

図6は、本実施形態に係る半導体記憶装置1の電氣的な信号の流れを示すブロック図である。前記筐体10の内部に、これらの回路ブロックが収められている。

図6において、この半導体記憶装置1と当該半導体記憶装置1を利用するホスト装置（例えばビデオカメラレコーダやパーソナルコンピュータなど：図示せず）との接続は、物理的には前述のカードバスコネクタ13を通して、また電気信号的には図6のカードバスインタフェース14を通じて行われる。

このカードバスインタフェース14は、前記制御回路32に接続されており、ホスト装置との間で、書き込み、読み出しなどのコマンドやデータが伝送される。かかるカードバスインタフェース14を通じて行われる信号の電氣的な規定は、「PC Card Standard 8.0、Volume 2 Electrical Specification、p. 65～p. 186、2001年発行、PCMCIA」に記載されている。このカードバスインタフェース14では、例えば、最大133Mバイト／秒（以下ではMB／secと記す）の高速で書き込みあるいは読み出しのデータ転送が可能である。

本実施形態では、小型半導体メモリカード20として、SDアソシエーション

のSDメモリカード(R)規格に準拠したものが用いられており、前記制御回路32には、4枚のSDメモリカード(R)20と、書き込み禁止スイッチ8も接続されている。前記SDメモリカード(R)20として、例えば、容量が512Mバイト、データ転送速度が10MB/secのものが採用されている。

5 次に、書き込み時の動作について説明する。

ビデオカメラレコーダやパーソナルコンピュータなどのホスト装置(不図示)から半導体記憶装置1への書き込み時には、カードバスインタフェース14を通して書き込みコマンド、および書き込みデータが転送される。前記制御回路32では、4枚のSDメモリカード(R)20のそれぞれに対して書き込みコマンドを発行すると共に、書き込みデータを4系統に分割して並列化する。そして、このように4系統に分割して並列化した書き込みデータのそれぞれを、各SDメモリカード(R)20に対して同時に転送する。

この動作により、カードバスインタフェース14を通して転送された書き込みデータは、各々のデータ転送速度が10MB/secの4枚SDメモリカード(R)20に対して、4系統に並列化して書き込まれる。従って、全体としては40MB/secの速度でSDメモリカード(R)20に分割して記録される。また、4枚のSDメモリカード(R)20に分割して記録されるため、半導体記憶装置1全体としての記憶容量は4枚のSDメモリカード(R)20の記憶容量の合計となる。この例では、512Mバイトの4倍、つまり2Gバイトとなる。ここに、前記カードバスインタフェース14は、前述のように最大データ転送速度133MB/secの能力があるため、この40MB/secの転送速度を制限することはない。

例えば図1(c)から良く分かるように、前記半導体記憶装置1のカードバスコネクタ13と反対側の端部には、書き込み禁止スイッチ8が設けられている。このスイッチ8は、その開閉操作により、SDメモリカード(R)20への書き込みを禁止する禁止設定あるいはその解除設定を行うものである。

前記制御回路32は、カードバスインタフェース14を通じてホスト装置から書き込みコマンドを受け取った際に、書き込み禁止スイッチ8を参照し、その開閉状態に応じて、書き込みが禁止されている場合にはSDメモリカード(R)2

0への書き込みを行わないようになっている。

具体的には、前記制御回路32には、書き込み禁止スイッチ8の動作状態（開閉状態）をモニタするモニタ回路33（不図示）が設けられており、このモニタ回路33により、書き込み禁止スイッチ8が書き込み禁止側に設定されていることが検知されたときには、SDメモ리카ード（R）20への書き込みが禁止されるように制御する。

尚、この書き込み禁止の制御を半導体記憶装置1の制御回路32で行う代わりに、上記モニタ回路33の検知信号をホスト装置（例えばパーソナルコンピュータ）に送信し、このホスト装置の制御手段により、SDメモ리카ード（R）20への書き込みが禁止されるように制御することも可能である。また、前記モニタ回路33を制御回路32の外部に独立して設けることもできる。

以上のように書き込み禁止スイッチ8を操作することで、当該半導体記憶装置1に（つまり、各SDメモ리카ード（R）20に）既に記憶されたデータを不用意に消去してしまう誤操作を、有効に防止することができる。

この書き込み禁止スイッチ8は、筐体10のカードバスコネクタ13と反対側の端部に、筐体10の外部から操作可能に配置されている。従って、ホスト装置に筐体10を含むこの半導体記憶装置1が挿入されている状態においても、書き込み禁止スイッチ8の開閉状態の確認や操作を行うことが可能である。

次に、読み出し時の動作について説明する。

半導体記憶装置1からビデオカメラレコーダやパーソナルコンピュータなどのホスト装置への読み出し時には、カードバスインタフェース14を通してホスト装置側から読み出しコマンドが転送される。制御回路32では、書き込み時に4枚のSDメモ리카ード（R）20の各々に分割し並列化して記録されたデータを、各SDメモ리카ード（R）20からそれぞれ同時に読み出し、書き込み時とは逆の手順で、分割されたデータを統合する。そして、カードバスインタフェース14を通じて、ホスト装置へ転送するようになっている。

この動作により、各々のデータ転送速度が10MB/secの4枚のSDメモ리카ード20（R）について、4系統に並列化したデータを同時に読み出して統合することができる。従って、全体としては40MB/secの速度でデータが

読み出せる。

次に、本実施形態に係る薄型でカード状の半導体記憶装置 1 の組立について、すなわち、サイズが限られた筐体 10 の内部に、4 枚の SD メモリカード (R) 20 や回路基板 30 及び制御回路 32 などが、どの様にして実装されるかについて説明する。

この説明に先立って、SD メモリカード (R) 20 の外形形状およびサイズについて説明する。図 7 は本実施形態に係る SD メモリカード (R) 20 の外形形状およびサイズを示す説明図で、図 7 (a) は平面図、図 7 (b) は図 7 (a) の Y7b-Y7b 矢印方向からの側面図、図 7 (c) は底面図、図 7 (d) は図 7 (c) の Y7d-Y7d 矢印方向からの側面図である。

尚、以下においては、SD メモリカード (R) の接続端子が設けられていない平面を上面、9 個の接続端子 21 が設けられている平面を下面と称し、また、側面については、接続端子 21 が設けられている側を前面と呼ぶことにする。

図 7 (a) ~ (d) に示されるように、SD メモリカード (R) 20 は、幅の呼び寸法が 24.0 mm、長さの呼び寸法が 32.0 mm、最大厚さの呼び寸法が 2.1 mm に設定されている。すなわち、厚さ方向については、幅方向における中央部分 20a (幅 22.5 mm の部分) は厚さの呼び寸法が 2.1 mm であるが、幅 0.75 mm ( $= (24.0 - 22.5) / 2$ ) の左右の端部分 20b については、厚さの呼び寸法が 1.4 mm と薄く設定されている。図 7 (d) の部分拡大図から良く分かるように、この端部分 20b では、接続端子 21 が設けられた下面側のみがくぼんだ (えぐれた) 段付き形状を呈している。

このような SD メモリカード (R) 20 の形状は SD アソシエーションにより規格が定められており、その概略は、例えば、「TECHI PC カード/メモ리카ードの徹底研究、p. 216 ~ p. 230、2002 年 10 月、CQ 出版社」に紹介されている。

尚、上述の各呼び寸法の数値は、各サイズに対する標準寸法を示す数値であり、SD アソシエーションが定める規格に基づいて、それぞれ若干の公差が許容されている。

本実施形態に係る半導体記憶装置 1 には、図 1 (a) ~ (c) に示した外形形状及

びサイズを備えた筐体 10 内に、図 6 に示した回路ブロックを構成する各要素、すなわち図 7 (a)~(d)にその外形形状及びサイズを示した 4 枚の SD メモリカード (R) 20 に加え、回路基板 30 及び制御回路 32 などが実装されている。その実装状態は、前述の図 3 (a)~(c)及び図 4 に示されている。尚、これらの図においては何れも、筐体 10 は仮想線 (2 点鎖線) で表示されている。

これらの図を参照して前述したように、筐体 10 内には、4 枚の SD メモリカード (R) 20 を片面 (図 3 (b) における上面) に保持した回路基板 30 が配設され、この回路基板 30 他面 (図 3 (b) における下面) 側には制御回路 32 が配設されている。尚、この回路基板 30 の短辺方向における両縁部分は、筐体 10 の短辺方向における両端部分 10 b 内に保持されている。尚、前記制御回路 32 は、例えば大規模集積回路 (LSI) の形態で実装されている。

前記回路基板 30 にはカードバスコネクタ 13 からの信号線が接続されている (接続部は図示せず)。また、回路基板 30 の上面に平面状に配置される各 SD メモリカード (R) 20 は、9 個の接続端子 21 が設けられた面 (下面) を上向きにして回路基板 30 上に装着され、各接続端子 21 は接続ピン 31 を介して回路基板 30 に電氣的に接続される。尚、実際には、書き込み禁止スイッチ 8 も回路基板 30 に接続されるが、図が煩雑になることを回避するために、図示は省略されている。

ここで、図 7 (a)~(d)に示したように、各 SD メモリカード (R) 20 の幅の呼び寸法は 24.0 mm であるため、2 枚の SD メモリカード (R) を幅方向に並べた場合、2 枚合わせた幅寸法は 48.0 mm となる。

しかしながら、温度上昇による膨張や機械的ねじれ等を考慮すれば、2 枚の SD メモリカード (R) 20 間にある程度 (0.5 mm 程度) の間隙を設けておく必要がある。また、前述のように各 SD メモリカード (R) 20 の幅寸法には若干の公差が許容されており、この公差が  $\pm 0.1$  mm であるとすれば、この範囲内での寸法ばらつきも考慮しておく必要がある。すなわち、回路基板 30 上に 2 枚の SD メモリカード (R) 20 を幅方向に並べた状態での全体としての必要幅寸法は、少なくとも 48.7 mm ( $24.1 \text{ mm} + 0.5 \text{ mm} + 24.1 \text{ mm}$ ) となる。

一方、図1(a)~(c)に示したように、筐体10の中間部分10a(厚さが5.0mmの部分)の幅寸法は48.0mmである。このため、回路基板30上に配置した4枚のSDメモリカード(R)20全体を筐体10の中間部分10aに収めることは、幅方向における寸法が不足するため不可能であり、一部は左右の各端部分10b(厚さが3.3mm部分)にかかることになる。

ところで、厚さ方向について考えると、図7(a)~(d)に示したように、各SDメモリカード(R)20の厚さの呼び寸法は、幅方向における両端の一部を除いて2.1mmである。しかし、この厚さについての公差が $\pm 0.15$ mmであるとすれば、この範囲内での寸法ばらつきも考慮して、前記厚さは最大で2.25mmとなる。回路基板30の厚さは0.65mm程度であるので、両者を合わせて2.9mmの厚さが必要となる。

これに対して、筐体10の各端部分10bの厚さは3.3mmであり、また、この部分の筐体10の上下の部材の厚さがそれぞれ0.25mm程度である。従って、この端部分10bの内側空間の厚さ方向のサイズは、 $2.8\text{mm}(=3.3\text{mm} - (0.25 \times 2)\text{mm})$ しかなく、筐体10の左右両端部分10b(厚さが3.3mmの部分)内には、回路基板30とその上側に配置したSDメモリカード(R)20を収容するに足る厚さの空間を確保できないことになる。

尚、仮に回路基板30として0.1mmだけ薄い(厚さが0.55mmの)基板を用いた場合、回路基板とSDメモリカード(R)を合わせた全体厚さが2.8mmとなり、筐体10の前記端部分10b(厚さが3.3mmの部分)内に収容することが可能になる。しかし、この場合でも、回路基板30の下側には、筐体10の中間部分10aにおいても、厚さ方向に1mmに満たない空間しか確保できず、この回路基板30の下側空間に制御回路32を配置することはできない。

以上の状況に鑑み、本実施形態では、SDメモリカード(R)を回路基板30上に装着するに際して、各SDメモリカード(R)20の接続端子21が設けられた面を上向きにして装着するようにしている。図4に、この装着状態が詳しく示されている。

図7(a)~(d)に示したように、SDメモリカード(R)20は、その中央部分20aの厚みは2.1mmであるが、幅方向における両端部分20bは、その

厚さが1.4mmであり、この部分では、接続端子21が設けられた側がえぐられる(くぼむ)ことにより、中央部分20aに比べて薄くなっている(図7(d)参照)。またこの薄い端部分20bの幅は、左右両縁からそれぞれ0.75mmである。

5       そこで、図4に詳しく示すように、このSDメモ리카ード(R)20の左右両端の薄い部分20bの一部が、筐体10の中間部分10a(厚みが5.0mmの部分)からはみ出し、筐体10の左右両端部分10b(厚さが3.3mmの部分)内に収まるように、接続端子21が設けられた面を上向きにして、回路基板30上に装着するようにしている。

10       以上のような配置により、幅寸法が24.0mmの2枚のSDメモ리카ード(R)20を幅方向に並べ、さらに両者の間に0.5mm程度の隙間を確保した場合において、各SDメモ리카ード(R)20の幅寸法に公差(例えば、±0.1mm)があることを考慮しても、支障なく筐体10に收容することができる。

15       また、厚さ方向についても、回路基板30の下方に十分な余裕スペースがあることから、厚さが1.2mmの制御回路32を実装することが可能である。これにより、PCカードのタイプ2規格に準拠した外形形状及び寸法に設定された筐体10の内部に、図6に示した回路ブロックを全て収めることができる。つまり、4枚のSDメモ리카ード(R)20に加え、回路基板30及び制御回路32などを、收容することができるのである。尚、制御回路32は、LSIなどの電子部品で構成されており、はんだを用いて回路基板30に実装される。

20       更に、本実施形態では、例えば図5(a),(b)から良く分かるように、筐体10内に装着された4枚のSDメモ리카ード(R)20は、筐体10の長さ方向に並べて配置されたものどうしについて、その接続端子21が互いに接近する向きに装着される。

25       4枚のSDメモ리카ード(R)20の配置について、かかる構成を採用したことにより、筐体10の長さ方向における中央部近辺に4枚のSDメモ리카ード(R)の接続端子21が接近して位置することになり、各SDメモ리카ード(R)20につき9個ずつ必要とされる接続ピン31を、回路基板30の長さ方向における中央部近辺に集中して配置でき、接続ピン31の配設を効率良く行え

る。

また、例えば、図5 (a), (b) から良く分かるように、回路基板30の長さ方向における略中央部分に、多数の接続ピン31を取り付ける取付ベース35を設け、4枚のSDメモ리카ード(R)20に必要な接続ピン31の全てを、前  
5 記取付ベース35に対して一体的に取り付けることにより、接続ピン31の配設をより効率良く行え、製作コストの低減にも寄与できる。また、各SDメモ리카ード(R)20の装着作業も容易になる。また更に、回路基板30の下面の中央付近に配置された制御回路32との距離が短いことから、配線が短くなり、この間の信号劣化を防ぐことも可能となる。

10 この場合、図5 (b) に示されるように、各SDメモ리카ード(R)20は、回路基板30の上面に沿って前記取付ベース35に当接するまでスライドさせることにより、その接続端子21が接続ピン31と重なり合って確実に接触し、電気的な接続が確実に達成される。また、このとき、より好ましくは、SDメモ리카ード(R)20は、接続ピン31の上下方向の付勢力によって、回路基板30  
15 の上面との間に拘束される。或いは、この代わりに、各SDメモ리카ード(R)20を回路基板30の上面に接着固定するようにしても良い。

また更に、本実施形態では、筐体10は、上述のように、下側部材11と上側部材12とで形成される空間内に、上述の各内部部品を収容した上で、下側部材11及び上側部材12の周縁部及び／又はその近傍部分に、例えば熱硬化性の接  
20 着剤を適用することにより、両者を強固に接着固定するようにしている。

従って、一旦組み立てられた半導体記憶装置1は、容易に筐体10を開いて分解することはできない。すなわち、ユーザは、内部に実装されたSDメモ리카ード(R)20を筐体10の外部へ容易に取り出すことはできない。すなわち、この場合には、前記接着剤が、SDメモ리카ード(R)20が筐体10の外部へ取り出されることを規制する「規制機構」の役割を果たしている。  
25

前述したように、ホスト装置からの記録データは4系統に分割して4枚のSDメモ리카ード(R)20に記録されており、記録したデータを再現するためにはこれら4枚のSDメモ리카ード(R)20が揃っており、かつ、その配置が一定でなければならない。本実施形態では、筐体10の内部に実装されたSDメモリ



カード (R) 20 が筐体外に容易に取り出すことはできないので、4 枚の SD メモリカード (R) 20 がばらばらに保存されることはなく、その配置が常に一定に維持されるので、記録したデータを確実に再現することができる。

尚、SD メモリカード (R) 20 が筐体 10 の外部へ取り出されることを規制する「規制機構」としては、上述の接着剤以外に、種々の公知の技術が適用可能である。例えば、筐体 10 の下側部材 11 と上側部材 12 とを、熱溶着やスポット溶接あるいはリベット止めなどにより相互に固定することも可能である。更には、SD メモリカード (R) 自体を回路基板上に接着固定するようにしても良い。或いは、下側部材 11 と上側部材 12 とを、通常のドライバでは取り外しのでき

ない特殊形状のねじで固定するようにしても良い。

また、やはり従来公知の構造であるが、何れか一方の部材に係止用の突出片を設け、他方の部材にこの突出片を挿通させるスリット状の開口を設けておき、両部材を組み合わせることで、前記突出片を前記スリット状開口に挿通させ、その後、専用の工具を用いて突出片の先端側を折り返すことにより、下側部材 11 と上側部材 12 とを機械的に結合することもできる。この場合についても、両部材の結合を解除して筐体を分解するには専用の工具が必要なるので、ユーザは容易に SD メモリカード (R) を外部へ取り出すことはできない。

以上、説明したように、本実施形態に係る薄型でカード状の半導体記憶装置 1 は、PC カード規格に準拠した外形形状及びサイズに設定された筐体 10 に、4 枚の SD メモリカード (R) 20 と、これらの SD メモリカード (R) 20 を制御する制御回路 32 を内蔵している。そして、ホスト装置からの信号をこれら 4 枚の SD メモリカード (R) 20 に並列に記憶し、また読み出しすることで、1 枚の SD メモリカード (R) 20 の場合に比して、4 倍の高いデータ転送レートと 4 倍の大きな記憶容量が得られる。これにより、高画質な動画像を長時間記録するビデオカメラレコーダなど、より高いデータ転送レートとより大きな記憶容量が求められるホスト装置において、その記録媒体として用いるのに適した薄型の半導体記憶装置 1 を提供できるのである。

また、前記半導体記憶装置 1 は、PC カード規格に準拠した形態であるため、かかる PC カード装着用のスロットを備えた、例えば、一般的なノート型パーソナルコンピュータなどに容易に装着可能である。

ナルコンピュータなどのホスト装置に対して着脱が可能であり、その記録媒体として持ち運びができる。特に、専用のアダプタなどを用いることなく、一般的なノート型パーソナルコンピュータなどのホスト装置に対し直接に挿入することが可能で、記録した内容をホスト装置で確認したり、記録したデータをホスト装置によって編集したりするなど、データの取り扱いが容易となる。更に、ホスト装置とのインタフェースには、データ転送速度が最大133MB/secと高速なカードバスインタフェースを採用しているため、インタフェース部が転送速度を制限することは無い。

更に、前記半導体記憶装置1では、内蔵する小型半導体メモリとして、民生分野で大量に使用されるSDメモリカード(R)20を利用した構成であるため、比較的低価格で実現できる。これに加え、書き込み禁止スイッチ8を備えたことにより、すでにSDメモリカード(R)20内に記憶されたデータを不用意に消去してしまう誤操作を、有効に防止することができる。

尚、本発明は、以上の実施態様に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲において、種々の変更や改良を加え得るものであることは言うまでもない。

例えば、本実施形態では、回路基板30の上面に、接続端子21を上向きにして平面状に4枚のSDメモリカード(R)20を配置し、回路基板30の下面に制御回路32を配置した構成としたが、これら全体の上下関係を逆にしてもよい。すなわち、回路基板の下面に端子部を下向きにして平面状に4枚のSDメモリカード(R)を配置し、回路基板の上面に制御回路を配置した構成としても実現できることは言うまでもない。

また、本実施形態では、複数の小型半導体メモリカードとしてSDメモリカード(R)を4枚用いる構成としたが、例えばマルチメディアカードなど他の種類の小型半導体メモリカードを用いるようにしても良く、更に、使用する小型半導体メモリカードの枚数も、4枚に限られるものではない。

また更に、本実施形態に係る半導体記憶装置1では、その筐体10の外形形状及びサイズを、PCカード規格のタイプ2型に準拠したものとしたが、本発明はこれに限られるものではない。幅や長さが異なっても、厚みが5.0mm程

度以下のカード形状にすることで携帯性を確保できる。例えば、幅の呼び寸法が 34.0mm、長さの呼び寸法が 75.0mm、最大部分の厚さの呼び寸法が 5.0mm のカード形状であってもよいし、幅の呼び寸法が 54.0mm、長さの呼び寸法が 75.0mm、最大部分の厚さの呼び寸法が 5.0mm のカード形状であってもよい。

また更に、本実施形態では、ホスト装置とのインタフェースをカードバスインタフェースとしたが、これに限られるものではなく、他のインタフェースを用いることができる。例えば、シリアル形態で信号を伝送する PCI Express 規格に準拠したインタフェースを採用することで、より高速なデータ転送を可能とすることもできる。

以上のように、本実施形態によれば、例えば高画質な動画像を長時間記録するビデオカメラレコーダなど、より高いデータ転送レートとより大きな記憶容量が求められるホスト装置に対して、その記録媒体として用いるのに適し、ホスト装置との着脱が可能で持ち運びができ、かつ比較的低価格で得られる薄型でカード状の半導体記憶装置が得られる。

また、例えば、一般的なノート型パーソナルコンピュータなどのホスト装置においても、専用のアダプタ等を用いること無く、直接に挿入して使用することができ、記録した内容をパーソナルコンピュータ等のホスト装置で確認したり、記録したデータを編集したりするなどのデータの取り扱いが容易に行えるようになるという、効果も得られる。

#### 産業上の利用の可能性

以上のように、本発明の半導体記憶装置によれば、高いデータ転送レートと大きな記憶容量が実現でき、また、ホスト装置との着脱が可能で持ち運びができ、かつ比較的低価格で得られるので、例えば、高画質な動画像を長時間記録するビデオカメラレコーダ等の記録媒体として好適である。また、PCカード用スロットに、専用のアダプタ等を用いること無く直接に挿入して使用することができるので、一般的なノート型パーソナルコンピュータ等の記録媒体としても好適に用いることができる。

## 請求の範囲

1. ホスト装置と接続するための接続部を有する筐体と、  
該筐体内に収納された複数の小型半導体メモリカードと、  
5 前記接続部と前記複数の小型半導体メモリカードとの間の信号の送受信を制御する制御手段と、  
を備えたことを特徴とする半導体記憶装置。  
2. 前記筐体は、平面視で実質的に矩形状に形成されると共に、その短辺方向における所定幅の両端部分が同方向における中間部分よりも薄く設定されており、  
10 前記筐体内に複数の前記小型半導体メモリカードが平面状に収納され、  
前記短辺方向に前記小型半導体メモリカードが少なくとも2枚並べて配設されている、  
ことを特徴とする請求項1記載の半導体記憶装置。  
3. 前記筐体内に4枚の前記小型半導体メモリカードが収納され、  
15 前記筐体の長辺方向にも小型半導体メモリカードが2枚並べて配設されている、  
ことを特徴とする請求項2記載の半導体記憶装置。  
4. 前記中間部分は、前記両端部分から筐体の厚さ方向における片方および他方へそれぞれ張り出す第1および第2張出部を備えており、  
前記小型半導体メモリカードは前記第1張出部側に、その一部が前記中間部分  
20 よりも薄く設定された両端部分にかかるように収納され、  
前記第2張出部側には、前記制御手段が配設されている、  
ことを特徴とする請求項2又は3に記載の半導体記憶装置。  
5. 前記小型半導体メモリカードの保持部が片面に設けられた回路基板を更に備え、  
25 該回路基板の他面側に前記制御手段が配設されている、  
ことを特徴とする請求項1～4の何れか一に記載の半導体記憶装置。  
6. 前記回路基板の一方向における両縁部分は、前記筐体の短辺方向における前記両端部分に支持されていることを特徴とする請求項5記載の半導体記憶装置。  
7. 前記筐体は、最大厚さ部分の呼び寸法が5.0mm以下のカード形状である

ことを特徴とする請求項 1 ～ 6 の何れかーに記載の半導体記憶装置。

8. 前記筐体は、幅の呼び寸法が 54.0 mm、長さの呼び寸法が 85.6 mm の P C カード規格に準拠した大きさであることを特徴とする請求項 1 ～ 7 の何れかーに記載の半導体記憶装置。

5 9. 前記筐体は、幅の呼び寸法が 54.0 mm、長さの呼び寸法が 85.6 mm、最大厚さ部分の呼び寸法が 5.0 mm に規定された P C M C I A の P C カード規格タイプ 2 に準拠した大きさであることを特徴とする請求項 8 記載の半導体記憶装置。

10 10. 前記小型半導体メモリカードは、幅の呼び寸法が 24.0 mm、長さの呼び寸法が 32.0 mm、最大厚さの呼び寸法が 2.1 mm に規定された S D アソシエーションの S D メモリカード (R) 規格に準拠したものであることを特徴とする請求項 1 ～ 9 の何れかーに記載の半導体記憶装置。

15 11. 前記筐体内には、回路基板と、該回路基板の上面に端子部を上向にして平面状に配置された S D メモリカード (R) 規格に準拠した複数枚の小型半導体メモリカードと、前記回路基板の下面に配置された制御手段とを備えたことを特徴とする請求項 10 に記載の半導体記憶装置。

20 12. 前記筐体内には、回路基板と、該回路基板の下面に端子部を下向にして平面状に配置された S D メモリカード (R) 規格に準拠した複数枚の小型半導体メモリカードと、前記回路基板の上面に配置された制御手段とを備えたことを特徴とする請求項 10 に記載の半導体記憶装置。

13. 前記筐体には、前記小型半導体メモリカードが筐体外へ取り出されることを規制する規制機構が設けられていることを特徴とする請求項 1 ～ 12 の何れかーに記載の半導体記憶装置。

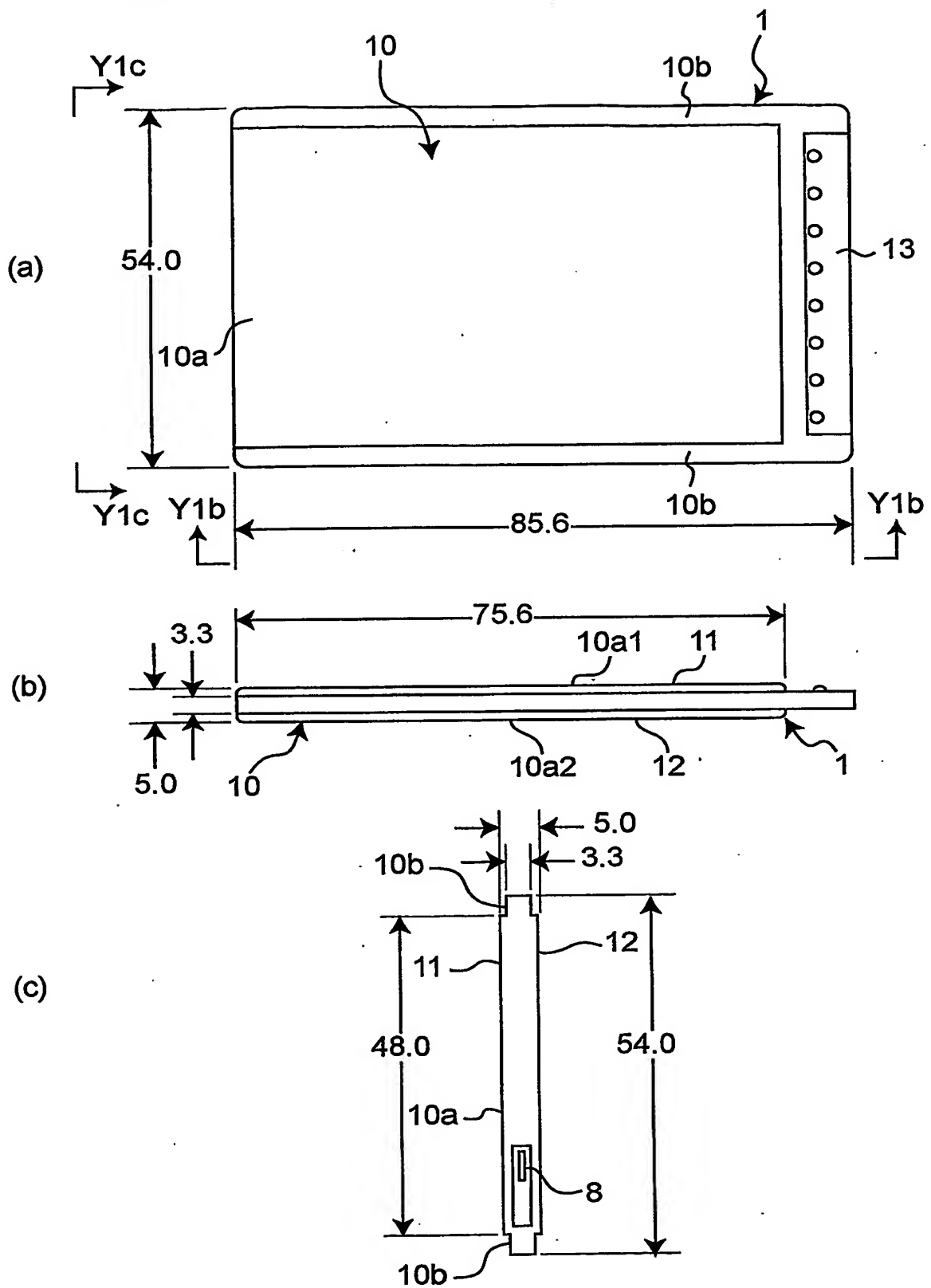
25 14. 前記筐体は、筐体外部から動作状態を設定し得るスイッチ手段を備えており、

前記スイッチ手段の動作状態をモニタするモニタ手段が設けられ、

該モニタ手段により前記スイッチ手段が書き込み禁止側に設定されていることが検知されたときには、前記小型半導体メモリカードへの書き込みを禁止するように制御される、

ことを特徴とする請求項 1 ～ 13 の何れか一に記載の半導体記憶装置。

図1



2/7

図2

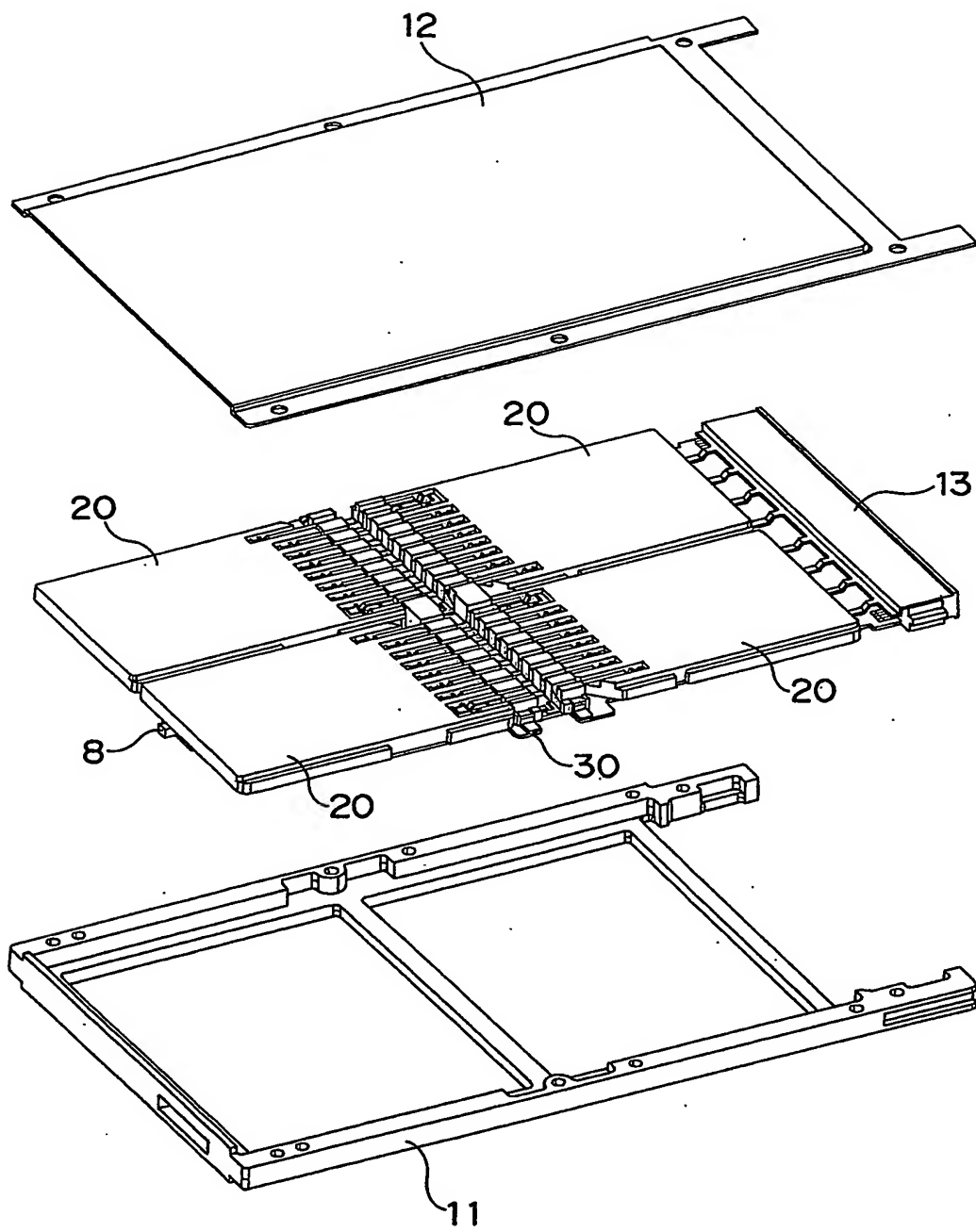




图3

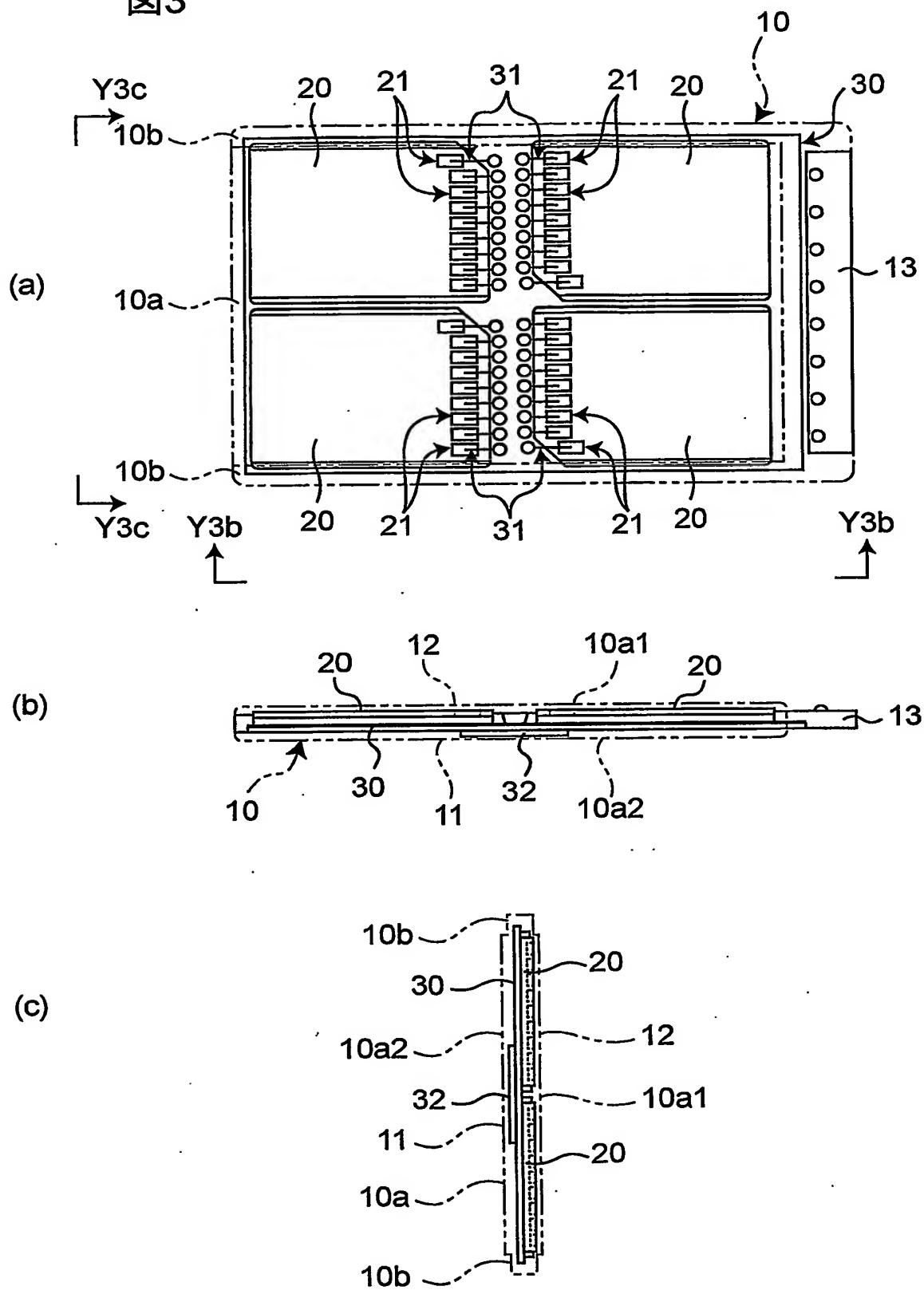


図4

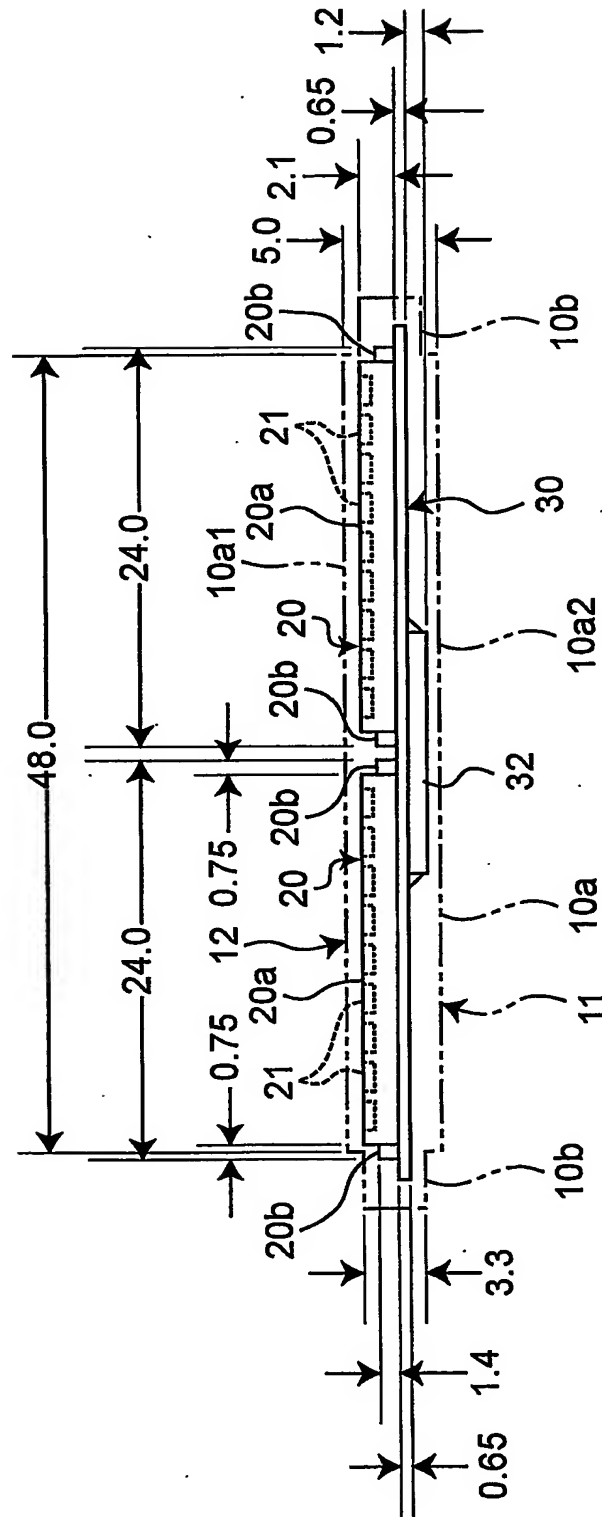


図5

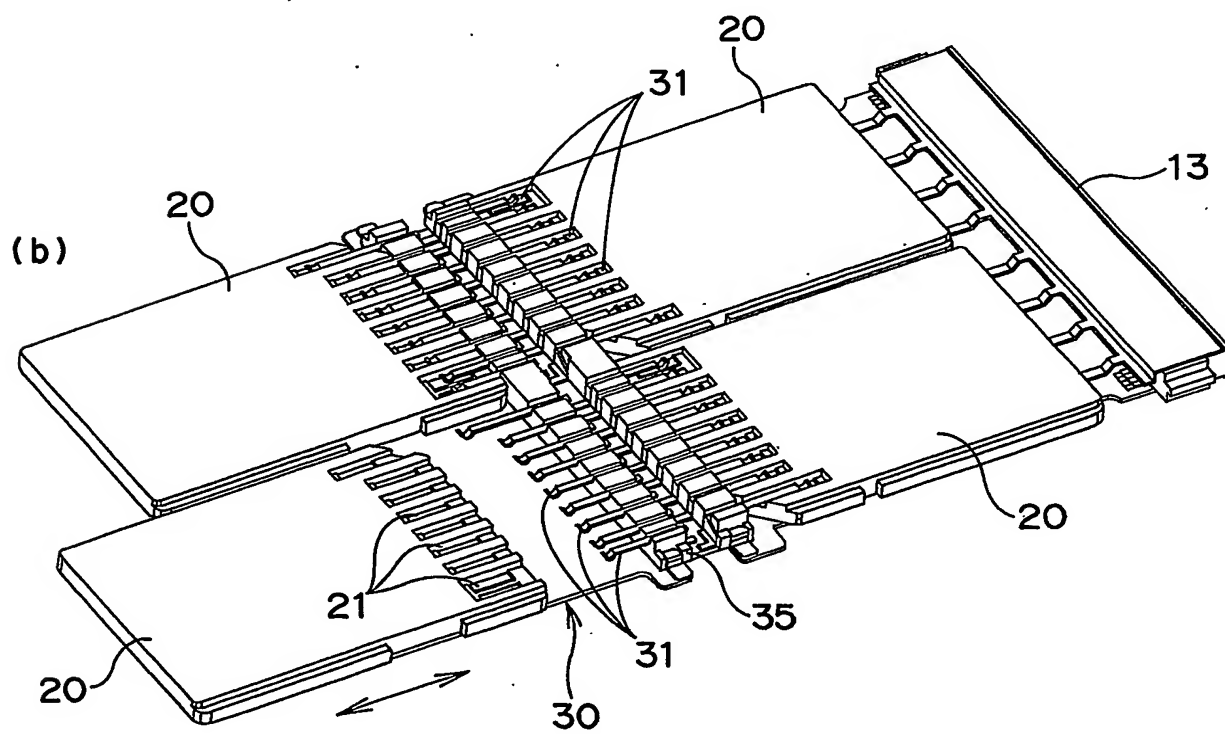
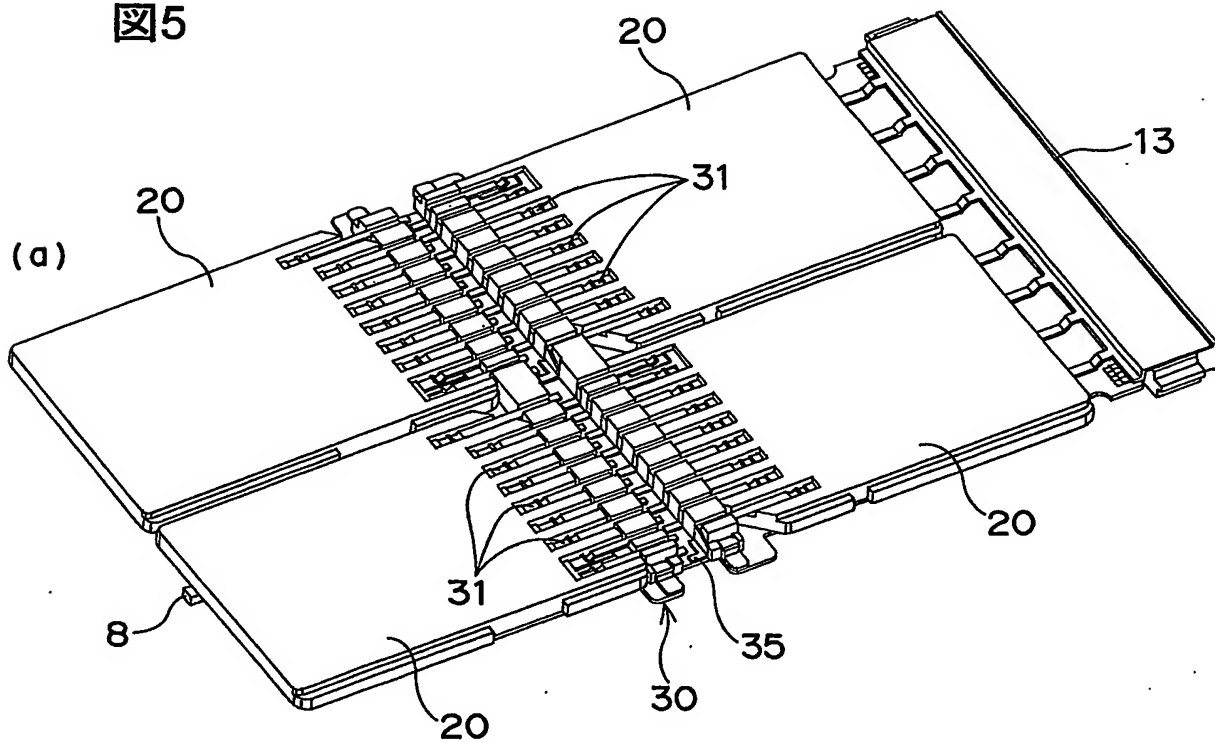


図6

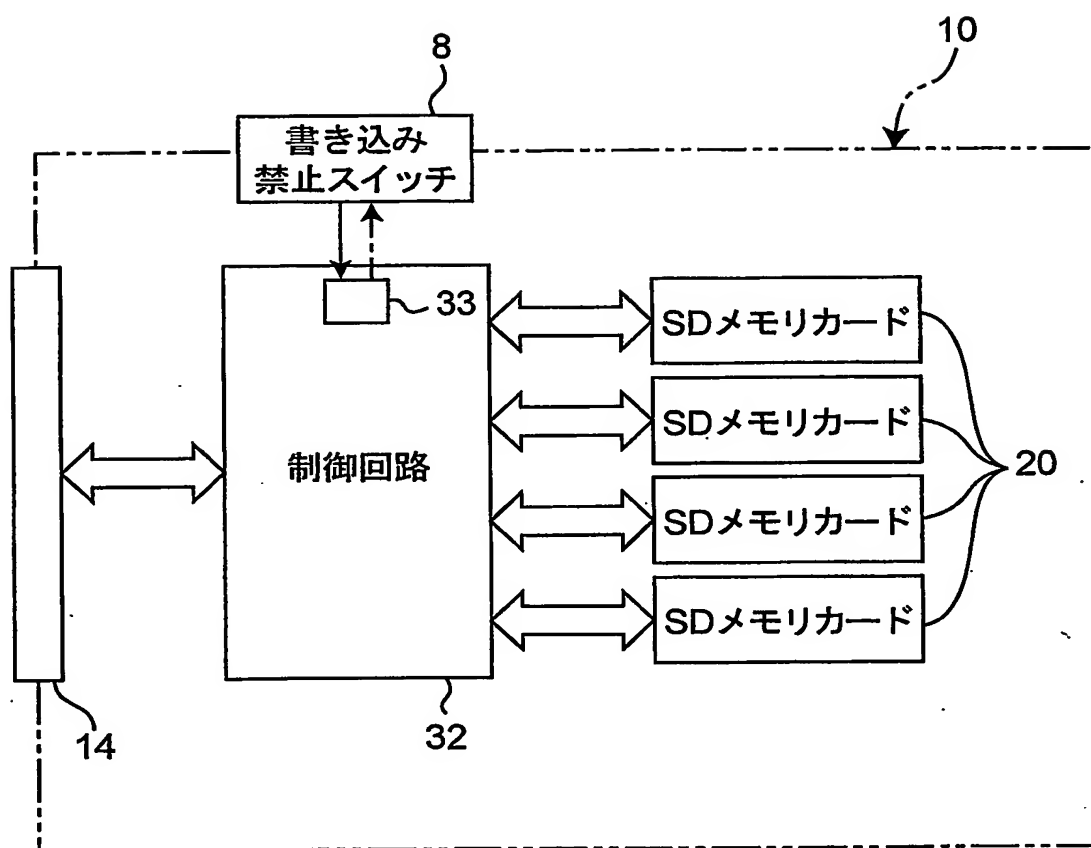
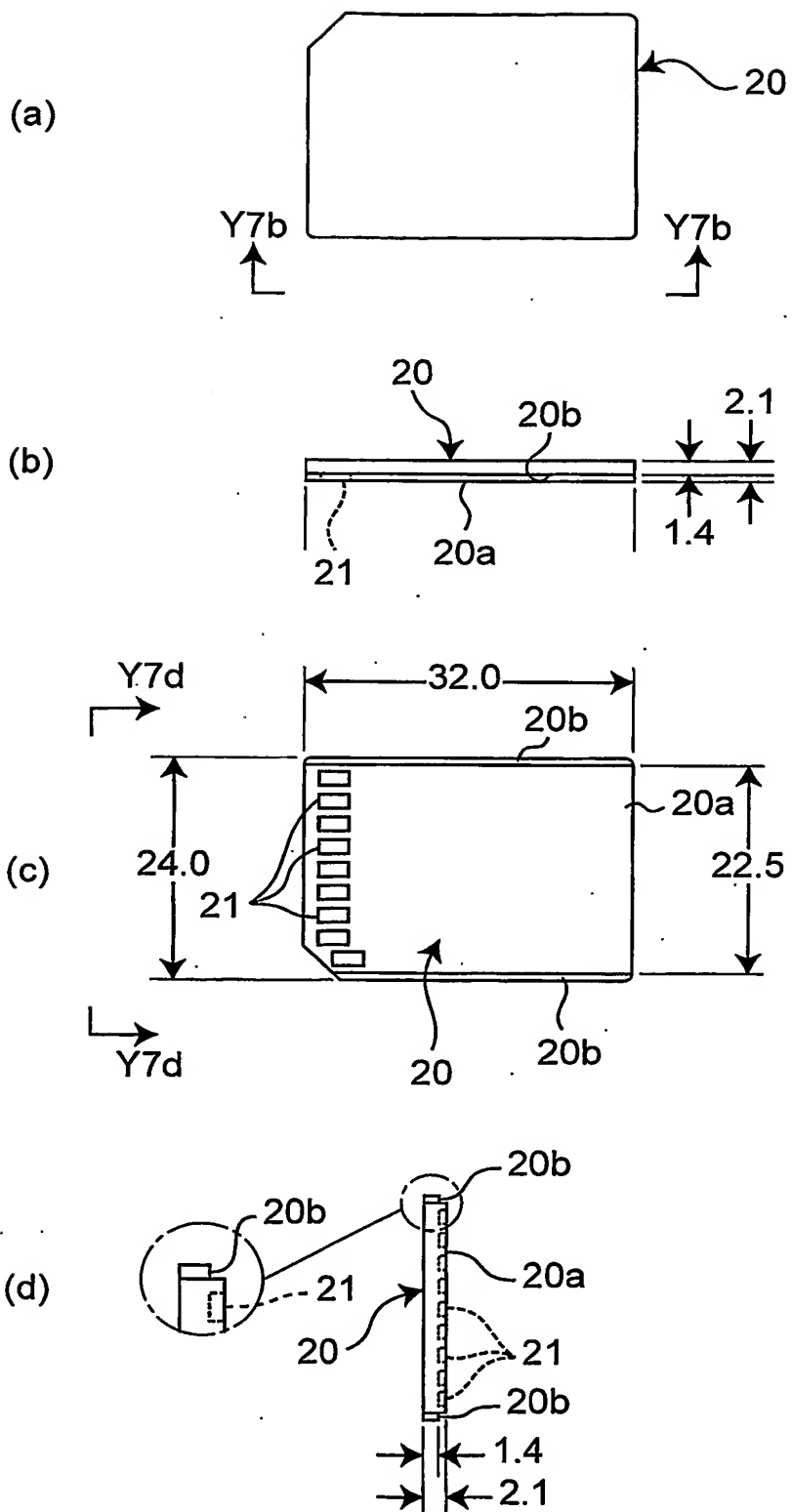


図7



# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP03/15833

## A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

Int.Cl<sup>7</sup> G06K17/00, G06F12/06, G06F3/06, G06F3/08

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

## B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl<sup>7</sup> G06K17/00, G06K19/00-19/18, G06F12/06, G06F3/06, G06F3/08

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho	1922-1996	Jitsuyo Shinan Toroku Koho	1996-2004
Kokai Jitsuyo Shinan Koho	1971-2004	Toroku Jitsuyo Shinan Koho	1994-2004

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

## C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X Y A	JP 2002-189992 A (Sony Corp.), 05 July, 2002 (05.07.02), Full text; all drawings (particularly, Claim 1; Fig. 1) & US 2002/0078297 A1	1-3 7-10, 14 4-6, 11-13
X Y A	JP 2001-188883 A (Toshiba Corp.), 10 July, 2001 (10.07.01), Full text; all drawings (particularly, Claim 1; Par. Nos. [0014], [0027] to [0035]) (Family: none)	1-3 7-10, 14 4-6, 11-13

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☐ See patent family annex.

\* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier document but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"I" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search  
16 March, 2004 (16.03.04)

Date of mailing of the international search report  
30 March, 2004 (30.03.04)

Name and mailing address of the ISA/  
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP03/15833

## C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X Y A	JP 2001-306182 A (Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.), 02 November, 2001 (02.11.01), Full text; all drawings (particularly, Claims 1, 8; Par. No. [0017]) & WO 2001/080171 A1 & US 2003/0109179 A1	1,2,7-9 10,14 3-6,11-13
X Y A	JP 6-195524 A (Toshiba Corp.), 15 July, 1994 (15.07.94), Par. Nos. [0064] to [0066]; Fig. 32 (Family: none)	1 7-10 2-6,11-14
Y	PC Card Standard, Release 7.0, 1999.02, PCMCIA, JEIDA, Vol.3, Physical Specification, pages 5, 3. Card Dimensions, 3.1 Write Protect Switch (WPS), Figure 11-3	7-9,14
Y	JP 2001-357943 A (Matsushita Electric Works, Ltd.), 26 December, 2001 (26.12.01), Par. No. [0003] (Family: none)	10
Y	WO 2000/068770 A1 (SOCKET COMMUNICATIONS, INC.), 16 November, 2000 (16.11.00), Page 3, line 30 to page 4, line 5 & JP 2003-502727 A & US 6353780 B1	10
A	JP 8-315100 A (LG Semicon Co., Ltd.), 29 November, 1996 (29.11.96), Par. Nos. [0016], [0017], [0031] to [0033] & US 5712811 A	1-14
E,X	JP 2004-38353 A (Toshiba Corp.), 05 February, 2004 (05.02.04), Par. Nos. [0008], [0009]; Figs. 1 to 2 (Family: none)	1-2,7-9

## A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl.<sup>7</sup> G06K17/00, G06F12/06, G06F3/06, G06F3/08

## B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl.<sup>7</sup> G06K17/00, G06K19/00-19/18, G06F12/06, G06F3/06, G06F3/08

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報	1922-1996年
日本国公開実用新案公報	1971-2004年
日本国実用新案登録公報	1996-2004年
日本国登録実用新案公報	1994-2004年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

## C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X Y A	J P 2002-189992 A (ソニー株式会社) 2002. 07.05, 全文, 全図(特に、請求項1, 図1) & US 2002/0078297 A1	1-3 7-10, 14 4-6, 11-13
X Y A	J P 2001-188883 A (株式会社東芝) 2001. 0 7.10, 全文, 全図(特に、請求項1, 【0014】, 【002 7】 ~ 【0035】) (ファミリー無し)	1-3 7-10, 14 4-6, 11-13
X Y	J P 2001-306182 A (松下電器産業株式会社) 20 01.11.02, 全文, 全図(特に、請求項1, 請求項8, 【00	1, 2, 7-9 10, 14

☒ C欄の続きにも文献が列举されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

## \* 引用文献のカテゴリー

「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの  
「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの  
「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)  
「O」 口頭による開示、使用、展示等に関する文献  
「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献  
「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの  
「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの  
「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの  
「&」 同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

16.03.2004

国際調査報告の発送日

30.3.2004

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP)  
郵便番号 100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

夏目 健一郎

5N

4227

電話番号 03-3581-1101 内線 3545



C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
A	17】) & WO 2001/080171 A1 & US 2003/0109179 A1	3-6, 11-13
X	JP 6-195524 A (株式会社東芝) 1994. 07. 1	1
Y	5, 【0064】～【0066】, 図32 (ファミリー無し)	7-10
A		2-6, 11-14
Y	PC Card Standard, Release 7.0, 1999.02, PCMCIA, JEIDA, Volume 3, Physical Specification, p.5, 3. Card Dimensions, 3.1 Write Protect Switch (WPS), Figure 11-3	7-9, 14
Y	JP 2001-357943 A (松下電工株式会社) 200 1. 12. 26, 【0003】 (ファミリー無し)	10
Y	WO 2000/068770 A1 (SOCKET COMMUNICATIONS, I NC.), 2000. 11. 16, 第3ページ第30行目～第4ページ第5 行目 & JP 2003-502727 A & US 635 3780 B1	10
A	JP 8-315100 A (エル・ジー・セミコン・カンパニー ・リミテッド) 1996. 11. 29, 【0016】、【001 7】、【0031】～【0033】 & US 5712811 A	1-14
EX	JP 2004-38353 A (株式会社東芝) 2004. 0 2. 05, 【0008】、【0009】、図1-2 (ファミリー無 し)	1-2, 7-9